

# Rudolf Pack GmbH&Co KG



**PACK**  
LitzWire

for a better  
power efficiency

Herr Pack, Ihr Unternehmen besteht seit 90 Jahren. Bitte beschreiben Sie Ihre Firma in wenigen Worten.

Maßgeschneiderte Produkte aus Feindraht und Hochfrequenzlitzen sind das Markenzeichen der 1933 gegründeten Firma Pack. Besonders erwähnenswert sind ihre über Jahrzehnte aufgebaute hohe Technologiekompetenz sowie die von ihr realisierten Qualitätsstandards. Die gesamte Wertschöpfungskette der Litzenherstellung wird dabei im eigenen Hause umgesetzt. Spezialisierte Maschinenbaukenntnisse ermöglichen eine permanente Anpassung des Litzendesigns und der Fertigungstechnik. Seit nunmehr über fünfzehn Jahren investiert Pack gezielt in Forschungsvorhaben im Verbund mit Kunden und Universitäten, um auch systematisch Grundlagenforschung in die Herstellung von HF-Litzen einfließen zu lassen.

Herr Pack, welches Produktspektrum bieten Sie an?

Wir entwickeln und produzieren seit fast 50 Jahren Kupferlackdrähte und HF-Litzen für die Elektroindustrie und die Leistungselektronik. Wir kennen die Anforderungen unserer Kunden bis ins Detail – und liefern hochwertige und passgenaue Produkte, die unsere Kunden voranbringen.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

- RUPALIT® HF-Litzen als Programmschwerpunkt
- anwendungsbezogene Konfektionierung
- Flexibilität und Schnelligkeit auch bei individuellen Anforderungen
- Lieferung auch kleiner Mengen
- Fertigung nach verschiedenen Standards (DIN, VDE, EN, IEC, UL).

Und in welche Branchen liefern Sie?

Hochfrequenzlitzen als typische Querschnittstechnologie wird in vielen Branchen eingesetzt, wo eine effiziente Stromversorgung eine wichtige Rolle spielt. Als Branchen sind E-mobility, Erneuerbare Energien, Industrieelektronik, Bahntechnik, Medizintechnik und Luftfahrt zu nennen.

Welche Neuheiten/Innovationen/derzeitige Aktivitäten verfolgen Sie derzeit?

Angesichts der aktuellen multiplen Herausforderungen wie Energieversorgung, Lieferketten, Konjunktur und Geopolitik verfolgen wir ein striktes Programm der Resilienzsteigerung in vielen Bereichen. In technologischer Hinsicht arbeiten wir in diversen Forschungsprojekten, u.a. an der universellen Nutzung von Hochfrequenzlitzen bei Anwendungen hocheffizienter Megahertz-Leistungselektronik. Ebenso sind HF-Litzenentwicklungen für die Serienfertigung im Bereich E-Mobilität/Drahtlose Stromübertragung-Wireless Power Transfer/Induktive Ladetechnik wichtige Themen.

Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

Webseite: [www.packlitzwire.com](http://www.packlitzwire.com)

Ansprechpartner: Rainer Pack, [rainer.pack@packlitzwire.com](mailto:rainer.pack@packlitzwire.com)  
Dietmar Exner (Product Manager), [dietmar.exner@packlitzwire.com](mailto:dietmar.exner@packlitzwire.com)

